

PEAK™ UNIVERSAL BOND

Valokovetteinen resiini klooriheksidiinillä 0,2 %



Inspiral Brush -kärki

AINUTLAATUISET EDUT

- Sidostuu dentiiniin, kiilteeseen, posliiniin, metalliin, muoveihin sekä zirkoniaan
- Ideaalinen epäsuoraan ja suoraan sidostuksiin sekä nastoihin ja pilarinrakentamiseen
- Käy itse-etsaus- ja total-etch-tekniikoihin
- Pitkäaikaiset hyvät sidokset

PAKKAUSKOOT

PEAK UNIVERSAL SE BOND -pakkaus

Tuotenro 36176 | Valm. koodi 4554

1 kpl Peak Universal Bond -ruisku 1,2 ml

1 kpl Peak SE Primer -ruisku 1,0 ml

20 kpl Black Mini Brush -kärkiä

20 kpl Inspiral Brush -kärkiä

Säilyvyysaika: 18 kk. Säilytetään jääkaapissa.

PEAK UNIVERSAL LC BOND -täyttöpakkaus

Tuotenro 36175 | Valm. koodi 4553

4 kpl Peak Universal Bond -ruiskuja 1,2 ml

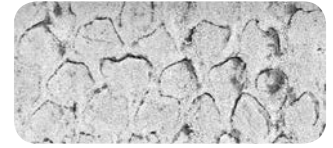
Säilyvyysaika: 18 kk. Säilytetään jääkaapissa.

PEAK UNIVERSAL LC BOND -refill

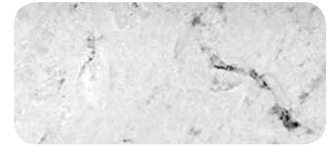
Tuotenro 39166 | Valm. koodi 4543

1 kpl Peak Universal Bond -pullo 4 ml

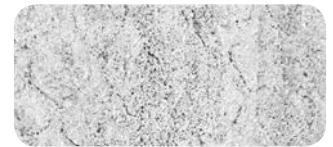
Säilyvyysaika: 18 kk. Säilytetään jääkaapissa.



Yliopistotutkimus, elokuu 2007²
1. Mikrokooppikuva leikatusta kiilteestä, käsitelty Peak SE Primerilla. Huomaa etsattujen kiilleprismojen reikäinen ulkonäkö.



2. Mikrokooppikuva leikatusta kiilteestä, joka on käsitelty Clearfil SE Bondilla.



3. Mikrokooppikuva leikatusta kiilteestä, joka on käsitelty Adper Prompt L-Popilla.

Riippumattomassa yliopistotutkimuksessa todetaan Peakin ylivoimaisuus etsauksessa ja sidostuksessa: Bond Strengths of Self-Etching Bonding Systems to Dentin and Enamel - R.B. PRICE, M. MCLEOD, and C.M. FELIX, Dalhousie University, Halifax, Canada.

LEIKATTU KIILLE

SIDOSTUSJÄRJESTELMÄ	SIDOSLUJUUS (MPa)
Ultra-Etch + Peak LC	40,7 a
Peak SE + Peak LC	38,3 a, b
Ultra-Etch + PQ1	37,3 b
Clearfil SE Bond	33,4 c
Prompt L-Pop	32,9 c

Sama kirjain (a, b, c) edustaa tilastollista samankaltaisuutta.

DENTIINI

SIDOSTUSJÄRJESTELMÄ	SIDOSLUJUUS (MPa)
Peak SE + Peak LC	35,7 a
Ultra-Etch + Peak LC	35,5 a
Clearfil SE Bond	35,1 a
Ultra-Etch + PQ1	33,7 a
Prompt L-Pop	25,0 b

TE - Kokonaisetsaustekniikka, SE - Itse-etsaustekniikka